

発表月日	発表開始時間	セッション名	プログラム番号	発表題目 和文	著者[1]	所属名称[1]
9月17日	9:00	パワーエレクトロニクス-1	1A1-1	オープンCAEによるパワー半導体の電気-熱連成解析と熱過渡解析への応用	八坂慎一	地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
	9:20	パワーエレクトロニクス-1	1A1-2	パワーデバイス用鉛高温はんだにおける接合プロセスと強度の関係	弓場 敦司	鹿児島大学
	9:40	パワーエレクトロニクス-1	1A1-3	疲労き裂進展則を用いたAgナノ粒子焼結体の疲労き裂発生寿命則導出	大崎 規二	芝浦工業大学大学院
	10:10	パワーエレクトロニクス-2	1A2-1	酸化銀還元反応を用いた銀-シリコン基板接合プロセスの低温化	川端玲	大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻
	10:30	パワーエレクトロニクス-2	1A2-2	低温焼結性銀微粒子による緻密な構造を有する無加圧焼結型ダイボンディングプロセスの実現と評価	奥田 真利	株式会社大阪ソーダ
	11:20	カーエレクトロニクス	1A3-1	直流反転電流がはんだ接合部のエレクトロマイグレーション進展に与える影響	藤野凌哉	中京大学
	11:40	カーエレクトロニクス	1A3-2	Sb添加がはんだ接合部エレクトロマイグレーションに与える影響	近藤直希	中京大学工学部
	12:00	カーエレクトロニクス	1A3-3	1200V級耐電圧車載用両面直接冷却型パワーモジュール向け樹脂絶縁構造の開発	露野 円文	株式会社日立製作所 研究開発グループ
	13:00	めっき技術-1	1A4-1	蛍光法による硫酸銅電気めっき液の評価	古賀淑哲	産業技術総合研究所センシングシステム研究センター
	13:20	めっき技術-1	1A4-2	微細配線対応のPd触媒フリー最終表面処理プロセスの開発	河崎 佳奈	奥野製業工業株式会社 総合技術研究部
	13:40	めっき技術-1	1A4-3	金属/封止樹脂間の密着性向上のための粗化ニッケルめっき技術	寺尾 幸泰	JX金属商事株式会社
	14:10	めっき技術-2	1A5-1	無電解Co-W-Bめっき膜のB含有率が膜構造とバリア性に及ぼす影響	伊井義人	上村工業株式会社
	14:30	めっき技術-2	1A5-2	銀被覆セラミック粉末を用いた導電性接着剤開発	中谷敏雄	東洋アルミニウム株式会社
	14:50	めっき技術-2	1A5-3	電析法によるピスマス負極材の表面構造制御と充放電特性	成本夏輝	大阪府立大学大学院 工学研究科
	9:00	プリンタブル・ウエアラブル・バイオエレクトロニクス-1	1B1-1	蓄エネルギー構造を有する新規水分センサの創成	泉 小波	産業技術総合研究所
	9:20	プリンタブル・ウエアラブル・バイオエレクトロニクス-1	1B1-2	金属箔エッチング配線を使用した平滑フィルム回路基板	和栗 一	東洋アルミニウム株式会社
	9:40	プリンタブル・ウエアラブル・バイオエレクトロニクス-1	1B1-3	インクジェットヘッド内部振動の等価回路解析における非線形素子モデリング	吉田 泰則	産業技術総合研究所 人間拡張研究センター
	10:10	プリンタブル・ウエアラブル・バイオエレクトロニクス-2	1B2-1	形状の異なる銀フィラーを二元分散させたワレタン系伸縮性印刷配線の機械的変形による電気抵抗率変化の解析	渡辺輝	群馬大学大学院理工学府
	10:30	プリンタブル・ウエアラブル・バイオエレクトロニクス-2	1B2-2	フラン樹脂由来活性炭への酸性表面官能基の導入と電気二重層キャパシタ特性	清水 翔太	大阪府立大学大学院 工学研究科 物質・化学系専攻 材料プロセス工学グループ
	10:50	プリンタブル・ウエアラブル・バイオエレクトロニクス-2	1B2-3	生体適合性材料をデバイスに使用するためのマテリアルズ・インフォマティクス技術	岩崎富生	(株)日立製作所 研究開発グループ
	11:20	プリンタブル・ウエアラブル・バイオエレクトロニクス-3	1B3-1	医療応用可能な高透明・高伸長な生体適合性電極の開発	荒木徹平	大阪大学産業科学研究所
	11:40	プリンタブル・ウエアラブル・バイオエレクトロニクス-3	1B3-2	行動下発汗量計測可能なヘルメットデバイス開発と新たな熱中症罹患早期推定指標への適用可能性	小須田 司	公立諏訪東京理科大学
	12:00	プリンタブル・ウエアラブル・バイオエレクトロニクス-3	1B3-3	薄膜有機トランジスタ用ゲート絶縁層の機械的負荷下での絶縁性能評価	日高 功二	鹿児島大学大学院 理工学研究科
	13:00	アディティブマニファクチャリング・立体回路基板	1B4-1	IoTエッジプラットフォーム”トリリオンノード・エンジン”におけるゴムコネクタ接続構造のピン数拡張	阿川 謙一	東芝デバイス&ストレージ株式会社
	13:20	アディティブマニファクチャリング・立体回路基板	1B4-2	放射光化学反応による粒子合成に関する固液界面依存性	山口明啓	兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所
	13:40	アディティブマニファクチャリング・立体回路基板	1B4-3	「電子機器が作れる複合3Dプリンター」向け設計環境	長谷川 清久	図研
	14:10	環境配慮型実装技術	1B5-1	太陽電池モジュール内部の酸性化に伴うはんだリボンの腐食挙動	仙波 妙子	ナミックス株式会社
	14:30	環境配慮型実装技術	1B5-2	クエン酸電解質のスクエアラブル垂鉛空気一次電池への適用性検討	渡邊敬仁	日本アイ・ピー・エム 東京基礎研究所

発表月日	発表開始時間	セッション名	プログラム番号	発表題目 和文	著者[1]	所属名称[1]
9月18日	8:20	最先端材料-1	2A1-1	大面積接合用シート型Ag焼結材料	酒 金輝	千住金属工業株式会社
	8:40	最先端材料-1	2A1-2	エポキシ系導電性接着剤の電気伝導特性と微細組織発達に及ぼすファイラー表面処理剤の効果	井上雅博	群馬大院理工
	9:00	最先端材料-1	2A1-3	次世代ロジックデバイス配線に向けた無電解Niめっき膜のバリア性能と電気特性評価	林藤 壮史	大阪府立大学大学院
	9:30	最先端材料-2	2A2-1	高周波向け新規エポキシ樹脂の開発	渡邊 隆明	三菱ケミカル株式会社
	9:50	最先端材料-2	2A2-2	Ag デンドライト結晶をCuスケルトン構造の表面に持つ薄膜の形成	和田郁海	中央大学工学部電気電子工学科
	10:10	最先端材料-2	2A2-3	Al-Zn合金板とFe板との間に発生した微細Cuデンドライト結晶薄膜形成	田邊ほの香	中央大学 工学部 電気電子工学科
	10:40	先端インターコネク	2A3-1	テンプレートストリッピングによる接合面平滑化に関する研究	日暮栄治	産業技術総合研究所
	11:00	先端インターコネク	2A3-2	Ag焼結材のプロセスウィンドウ拡大に向けた焼結雰囲気気の検討	小西 俊輔	千住金属工業株式会社
	11:20	先端インターコネク	2A3-3	銅ナノペーストとInjection Molded Solder法によるめっきフリーバンブ形成技術およびはんだ接合部の電気的特性評価	丸島 千波	日本アイ・ピー・エム株式会社 東京基礎研究所
	13:00	高速高周波・電磁特性技術-1	2A4-1	両端開放型マイクロストリップ線路共振器を用いたストリップ導体の実効導電率の導出手法の検討	高橋 徹	電気通信大学情報理工学研究所情報・ネットワーク工学専攻
	13:20	高速高周波・電磁特性技術-1	2A4-2	エンジニア教育からみた効果的な電磁波ノイズ対策について	金子俊之	株式会社CrossVate
	13:40	高速高周波・電磁特性技術-1	2A4-3	腕部に配置するウェアラブルコイルを利用する 人体周囲通信の伝送特性の検討	望月 幹太	東京工芸大学大学院 工学研究科
	14:10	高速高周波・電磁特性技術-2	2A5-1	透明導電膜を利用するアンテナの導電率に対する放射効率の検討	山田 友里	東京工芸大学 工学部
	14:30	高速高周波・電磁特性技術-2	2A5-2	広帯域半円台形不平衡ダイポールアンテナの円偏波化の検討	高橋 裕寛	東京工芸大学大学院 工学研究科
	14:50	高速高周波・電磁特性技術-2	2A5-3	多層プリント配線板で構成するパラボラアンテナにおけるオフセット方式による給電線路短縮の検討	松尾 佳樹	東京工芸大学大学院 工学研究科
	8:20	信頼性技術-1	2B1-1	温度サイクル試験/熱衝撃試験の効果比較検証	齋藤 結莉	エスベック株式会社
	8:40	信頼性技術-1	2B1-2	圧接構造を用いたパワーサイクル試験および焼結銅ダイボンド材のパワーサイクル信頼性	根岸 征央	日立化成株式会社
	9:00	信頼性技術-1	2B1-3	Agシタリングペーストを使用した半導体パッケージにおける フレームに対するプラズマ処理と信頼性評価結果	関真也	東芝デバイス&ストレージ株式会社 デバイス&ストレージ研究開発センター
	9:30	信頼性技術-2	2B2-1	環境曝露中における銅系導電性ペーストの微細組織と電気伝導特性変化の関係	齋藤優樹	群馬大学大学院理工学府
	9:50	信頼性技術-2	2B2-2	SOI-MOSデバイスにおける機械的応力効果の実験的評価	塩塚航生	鹿児島大学
	10:10	信頼性技術-2	2B2-3	各種冷熱衝撃試験におけるチップ下はんだ接合部の劣化挙動に関する研究	山崎 浩次	三菱電機株式会社先端技術総合研究所
	10:40	信頼性技術-3	2B3-1	電気・熱・応力連成解析によるパワーモジュール接合材におけるエレクトロマイグレーションの評価	加藤 光章	株式会社東芝 研究開発センター
	11:00	信頼性技術-3	2B3-2	機械学習を用いた良品解析による高信頼部品選定手法の研究	田中 章	株式会社東芝 生産技術センター
	11:20	信頼性技術-3	2B3-3	酸素アニールによるITO電極表面状態と(Pb,La)(Zr,Ti)O3キャパシタの劣化特性	石田 裕紀	大阪府立大学大学院工学研究科
	13:00	先端実装技術	2B4-1	メモリベース論理再構成デバイス(MRLD)におけるニューラルネットワークの実装	岡 緋紅	愛媛大学 大学院理工学研究科
	13:20	先端実装技術	2B4-2	直接接合に向けたスパッタNb薄膜の表面分析と窒化による影響の調査	高橋悠太	埼玉大院
	13:40	先端実装技術	2B4-3	電流密度解析を用いた経上皮電気抵抗計測用微小電極アレイの設計	宮崎真史	京都大学
	14:10	ものづくり	2B5-1	二次実装用接着剤エッジボンドの信頼性評価と分析	坂田 浩一	ザイメット
	14:30	ものづくり	2B5-2	電子機器用低温・短時間硬化接着剤	徳平 英士	富士通クオリティ・ラボ株式会社